

## 技術詞彙表

本詞彙表載有本文件所使用的與本公司及其業務有關的若干技術詞彙解釋。該等術語及涵義可能與該等詞彙的行業標準涵義或用法不一致。

本技術詞彙表載有本文件所用若干詞彙，乃由於該等詞彙與我們的業務有關。因此，該等詞彙及其定義未必經常與業內標準定義或該等詞彙的用途相符。

「ADAS」	指	進階駕駛輔助系統
「ADCU」	指	自動駕駛控制單元
「AI」	指	人工智能
「AIoT」	指	人工智能物聯網
「AI服務器」	指	為處理AI工作負載需求而專門構建的服務器
「AR」	指	增強現實
「ASIC」	指	專用集成電路
「縱橫比」	指	金屬化通孔的板厚與鑽孔直徑之比，或盲孔的孔深與鑽孔直徑之比
「背鑽」	指	一種去除金屬化通孔孔壁表面部分銅層的鑽孔工藝
「盲孔」	指	一種僅延伸至PCB單側表面的過孔
「埋孔」	指	一種不會延伸至PCB表面的過孔
「BGA」	指	球柵陣列
「BI」	指	商業智能
「BMS」	指	電池管理系統
「CAM」	指	電腦輔助製造
「CMA」	指	中國計量認證

---

## 技術詞彙表

---

「CPU」	指	中央處理器
「EAP」	指	設備自動化程序
「EMS」	指	電子製造服務
「ERP」	指	企業資源計劃
「ESG」	指	環境、社會及治理
「EV」	指	電動汽車
「FPGA」	指	現場可編程門陣列
「FPC」	指	柔性印刷電路板
「FR4」	指	阻燃等級4級，用於PCB的複合材料所採用的行業標準阻燃等級
「GLA」	指	總佔地面積
「GPS」	指	全球定位系統
「GPU」	指	圖形處理器
「HDI」	指	高密度互連
「HLC」	指	高多層
「IASB」	指	國際會計準則理事會
「IPD」	指	集成產品開發
「LDI」	指	激光直接成像
「LED」	指	發光二極管
「LiDAR」	指	光探測與測距
「MES」	指	製造執行系統
「mil」	指	等於千分之一英寸的長度單位
「MLPCB」	指	多層PCB

---

## 技術詞彙表

---

「MPCB」	指	金屬基PCB
「MRP」	指	物料需求規劃
「mSAP」	指	改進型半加成法工藝
「OLED」	指	有機發光二極管
「PCB」	指	印制電路板
「PPO」	指	聚苯醚
「半固化片」	指	亦稱為「PP片材」或「樹脂片材」，是一種由纖維增強材料浸漬熱固性樹脂後，固化至B階段（半固化狀態）製成的片材或卷材
「PTFE」	指	聚四氟乙烯，一種以四氟乙烯為單體經聚合反應合成的高分子材料
「剛撓結合板」	指	一種混合型印制電路板，將RPCB與FPC的特性集成於同一單元中
「RPA」	指	機器人流程自動化
「研發」	指	研究及開發
「RPCB」	指	剛性印制電路板
「SBTi」	指	科學碳目標倡議
「信號完整性」	指	信號在傳輸路徑上的質量
「SLP」	指	類載板
「SMT」	指	表面貼裝技術
「平方米」	指	平方米
「SRM」	指	供應商關係管理
「殘樁」	指	通孔中的殘留導電部分
「TOC」	指	制約理論

---

## 技術詞彙表

---

「通孔」	指	貫穿電路板鑽出的孔，用於在不同線路層之間形成電氣連接通路
「VR」	指	虛擬現實